

# Dell EMC PowerEdge C6420

## 仕様詳細

## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2017 - 2020 Dell Inc. またはその関連会社。。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

<b>1 Dell EMC PowerEdge C6420 の概要</b> .....	<b>4</b>
<b>2 技術仕様</b> .....	<b>5</b>
Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドの寸法.....	5
シャーシの重量.....	5
プロセッサの仕様.....	6
対応オペレーティングシステム.....	6
システムバッテリー.....	6
拡張バスの仕様.....	6
メモリの仕様.....	6
ドライブおよびストレージの仕様.....	7
ビデオの仕様.....	7
環境仕様.....	8
動作時の標準温度の仕様.....	8
動作時の拡張温度の仕様.....	15
粒子状およびガス状汚染物質の仕様.....	18
最大振動の仕様.....	19
最大衝撃の仕様.....	19
最大高度の仕様.....	19
Fresh Air 動作.....	20
<b>3 マニュアルリソース</b> .....	<b>21</b>
<b>4 困ったときは</b> .....	<b>23</b>
Dell EMC へのお問い合わせ.....	23
マニュアルのフィードバック.....	23
QRL によるシステム情報へのアクセス.....	23
C6400 および C6420 システム用 QRL.....	24
SupportAssist による自動サポートの利用.....	24
リサイクルまたはサービス終了の情報.....	24

# Dell EMC PowerEdge C6420 の概要

PowerEdge C6420 スレッドでは、最大 2 基のインテル Xeon スケーラブル プロセッサ（各プロセッサに 28 コア）がサポートされます。また、拡張および接続用に専用メザニン、PCIe、OCP（Open Compute Project）アダプタもサポートされます。

**メモ:** インテル Xeon スケーラブル プロセッサとファブリック コネクタは、ネイティブ **OmniPath** とも呼ばれます。

本項では、お使いのシステムの技術仕様と環境仕様の概要を示します。

トピック：

- ・ Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドの寸法
- ・ シャーシの重量
- ・ プロセッサの仕様
- ・ 対応オペレーティングシステム
- ・ システムバッテリー
- ・ 拡張バスの仕様
- ・ メモリの仕様
- ・ ドライブおよびストレージの仕様
- ・ ビデオの仕様
- ・ 環境仕様

## Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドの寸法

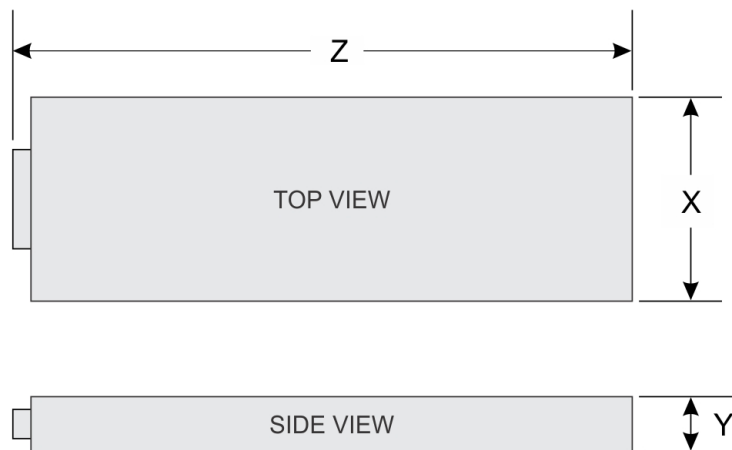


図 1. PowerEdge C6420 スレッドの寸法

表 1. PowerEdge C6420 スレッドの寸法

X	はい	Z
174.4 mm ( 6.86 インチ )	40.5 mm ( 1.59 インチ )	574.5 mm ( 22.61 インチ )

## シャーシの重量

表 2. スレッドを含めたエンクロージャのシャーシ重量

システム	最大重量 (すべてのスレッドおよびドライブ)
12 x 3.5 インチ ハードドライブ システム	43.62 Kg ( 96.16 ポンド )
バックプレーン システムなし	34.56 Kg ( 76.19 ポンド )

# プロセッサの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドは、それぞれ4基の独立したスレッド内に、最大2個のインテル Xeon Scalable プロセッサをサポートしています。各プロセッサでは、最大で28のコアがサポートされます。

**メモ:** ファブリック プロセッサと非ファブリック プロセッサが混在した環境では、ファブリック プロセッサをプロセッサ2のソケットに取り付ける必要があります。

# 対応オペレーティングシステム

Dell EMC PowerEdge C6420 は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server
- Canonical Ubuntu LTS
- VMware ESXi
- Citrix XenServer

**メモ:** 特定のバージョンおよび追加の詳細については、<https://www.dell.com/support/home/drivers/supportedos/poweredge-c6420> を参照してください。

# システムバッテリー

PowerEdge C6420 スレッドは、交換可能な CR 2032 3V コイン型リチウム電池を使用します。

**メモ:** 各スレッドにシステムのバッテリーがあります。

# 拡張バスの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドは、Generation 3 に対応した PCIe スロットを4基サポートします。

表 3. 拡張バスの仕様

PCIe スロット	説明	フォームファクタ
x8 メザニン PCIe ライザー	スロット 1: プロセッサ1からの x8 PCIe Gen3	カスタム フォーム ファクター
x8+x8 OCP メザニン ライザー	スロット 2: プロセッサ1からの x8 PCIe Gen3 スロット 3: プロセッサ1からの x8 PCIe Gen3	標準 Open Compute Project ( OCP ) フォーム ファクター
X16 PCIe メイン ライザー	スロット 4: x16 PCIe Gen3 プロセッサ1	標準ロープロファイル PCIe フォーム ファクター
x16 埋め込み型 PCIe ライザー	スロット 5: プロセッサ2からの x16 PCIe Gen3	カスタム フォーム ファクター

**メモ:** M.2 SATA ライザーは、埋め込みライザーでサポートされています。

# メモリの仕様

表 4. メモリの仕様

メモリモジュールソケット	DIMM のタイプ	DIMM のランク	DIMM の容量	シングルプロセッサ		デュアルプロセッサ	
				最小 RAM	最大 RAM	最小 RAM	最大 RAM
288 ピン ( 16 )	LRDIMM	クアドランク	64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1024 GB

メモリモジュール ソケット	DIMM の タイプ	DIMM のラ ンク	DIMM の容量	シングルプロセッサ		デュアル プロセッサ	
				最小 RAM	最大 RAM	最小 RAM	最大 RAM
		オクタルラ ンク	128 GB	128 GB	1024 GB	256 GB	2048 GB
	RDIMM	シングルラ ンク	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
		デュアルラ ンク	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
			32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
			64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1024 GB

## ドライブおよびストレージの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 のスレッドは、SAS および SATA ドライブと SSD (ソリッドステートドライブ) をサポートしています。

表 5. PowerEdge C6420 スレッドでサポートされているドライブオプション

エンクロージャ内の最大ドライブ数	スレッドごとに割り当てられる最大ドライブ数
12x3.5 インチ ドライブシステム	スレッドごとに 3 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD
24x2.5 インチ ドライブシステム	スレッドごとに 6 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD
24x2.5 インチ ドライブシステム、NVMe 搭載	NVMe バックプレーンは次の構成のいずれかをサポートします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>スレッドごとに 2 台の NVMe ドライブおよび 4 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD</li> <li>スレッドごとに 6 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD</li> </ul>
M.2 SATA ドライブ (オプション)	M.2 SATA カードでサポートされる容量は最大 240GB <b>メモ:</b> M.2 SATA カードは、x8 (スロット 1) メザニンライザーまたは x16 ライザー スロット (スロット 5) に取り付けることができます。
起動用 microSD カード (オプション) (最大 64 GB)	各スレッドの各 PCIe ライザーに 1 枚

表 6. M.2 SATA ドライブを使用した場合にサポートされる RAID オプション

オプション	1 台の M.2 SATA ドライブ (RAID なし)	2 台の M.2 SATA ドライブ (ハードウェア RAID あり)
ハードウェア RAID	無	有
RAID モード	該当なし	RAID 1
サポートされているドライブ数	1	2
サポートされているプロセッサ	プロセッサ 1	プロセッサ 1 および プロセッサ 2

## ビデオの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドは、16 MB RAM の Matrox G200 統合グラフィックスカードをサポートしています。

表 7. サポートされているビデオ解像度のオプション

解像度	リフレッシュレート (Hz)	色深度 (ビット)
1024 x 768	60	最大 24
1280 x 800	60	最大 24

解像度	リフレッシュレート (Hz)	色深度 (ビット)
1280 x 1024	60	最大 24
1360 x 768	60	最大 24
1440 x 900	60	最大 24

## 環境仕様

以下のセクションには、システムの環境仕様についての情報が含まれています。

**メモ:** 環境認定の詳細については、[www.dell.com/poweredgemanuals](http://www.dell.com/poweredgemanuals) の [ マニュアルおよび文書 ] にある『製品環境データシート』を参照してください。

## 動作時の標準温度の仕様

**メモ:**

1. 使用不可: 構成が Dell EMC で提供されていないことを示します。
2. 非対応: 構成が温度の面でサポートされていないことを示します。

**メモ:** 周囲温度が次の表に記載された継続動作時の最高温度以下である場合、DIMM、通信カード、M.2 SATA、PERC カードなどのすべてのコンポーネント ( Mellanox DP LP カードおよびインテル Rush Creek カードを除く ) は、十分な熱的余裕でサポートされます。

表 8. 動作時の標準温度の仕様

標準動作温度	仕様
温度範囲 ( 高度 950 m ( 3117 フィート ) 未満 )	10 ~ 35°C ( 50 ~ 95°F )、装置への直射日光なし。

**メモ:** 一部の構成では、周囲温度をより低くする必要があります。詳細については、次の表を参照してください。

表 9. ファブリック非対応デュアル プロセッサ構成の継続動作時最高温度

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ					BP 以外のシャーシ 該当なし	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ		4x ドライブ
205 W	8280	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8	非対応 ( 2°C )	非対応 ( 10°C )	非対応 ( 11°C )	非対応 ( 19°C )	20	21	21	21	21	30
	8280L	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8					20	21	21	21	21	30
	8280M	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8					20	21	21	21	21	30
	8270	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8					20	21	21	21	21	30
	8268	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6					20	21	21	21	21	30

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし	
		CPU2 : V2DRD	CPU2 : 8											
200 W	6254	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8	非対応 (6°C)	非対応 (14°C)	非対応 (15°C)	20	21	22	22	22	22	30	
165 W	8276	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	非対応 (11°C)	非対応 (18°C)	非対応 (19°C)	30	30	30	30	30	35	35	
	8276L	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35	
	8276M	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35	
	8260	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35	
	8260L	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35	
	8260M	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35	
	8260C	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35	
150 W	6252	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	非対応 (14°C)			21	23	30	30	30	30	35	35
	6248	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				21	23	30	30	30	30	35	35
	6240	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				21	23	30	30	30	30	35	35
	6242	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8				21	23	30	30	30	30	35	35

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
	6244	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240C	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
125 W	6230	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5220	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	8253	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
115 W	5217	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
105 W	5218T	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
		CPU2 : V2DRD	CPU2 : 8										
	8256	CPU1 : FMM2M   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6   CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	5215	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70 W	4209T	CPU1 : JYKMM   CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8   CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 10. 非ファブリック シングル プロセッサ構成の場合の継続動作時最高温度

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
205 W	8280	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
	8280L	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
	8280M	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
	8270	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
	8268	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
200 W	6254	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
165 W	6212U	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260C	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150 W	6210U	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6252	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6248	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6242	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6244	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240C	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし	
125W	6230	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8253	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
115 W	5217	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
105 W	5218T	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	5215	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ					BP 以外のシャーシ	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
70 W	4209T	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 11. Active (Optical) で接続した Mellanox Navi デュアル ポート カードの構成に関する制限事項

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
205 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	23
200 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	23
173 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	24	24	28
165 W	非対応	非対応	非対応	24	25	25	26	29
160 W	非対応	非対応	非対応	24	25	26	26	30
150 W	非対応	非対応	非対応	26	27	28	28	31
140 W	非対応	23	25	28	29	29	30	33
135 W	非対応	24	25	29	30	30	31	33
130 W	非対応	24	26	30	31	31	31	34
125 W	20	25	27	30	31	32	32	35
115 W	21	27	28	32	33	34	34	>35
113 W	21	27	28	32	33	34	34	>35
105 W	22	28	30	34	35	>35	>35	>35
85 W	23	32	33	>35	>35	>35	>35	>35
70 W	25	34	>35	>35	>35	>35	>35	>35

表 12. インテル Rush Creek の構成に関する制限事項

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
205 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	20	20	23
200 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	21	21	24
173 W	非対応	非対応	非対応	20	20	23	24	28
165 W	非対応	非対応	非対応	22	22	24	25	29
160 W	非対応	非対応	非対応	22	22	24	26	29
150 W	非対応	非対応	非対応	24	24	26	27	30
140 W	非対応	非対応	非対応	26	26	27	28	31
135 W	非対応	非対応	20	26	26	28	29	32
130 W	非対応	非対応	20	27	27	29	29	33
125 W	非対応	非対応	21	28	28	30	30	33
115W	非対応	21	23	29	31	31	32	34
105 W	20	23	24	30	33	33	34	>35

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
85 W	24	26	27	34	>35	>35	>35	>35
70 W	25	28	29	>35	>35	>35	>35	>35

表 13. インテル NVMe SSD AIC P4800X の構成に関する制限事項

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
205 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
200 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
173 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	20
165 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	20
160 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	25
150 W	非対応	非対応	非対応	非対応	20	20	20	25
140 W	非対応	非対応	非対応	20	20	20	20	25
135 W	非対応	非対応	非対応	20	20	20	20	25
130 W	非対応	非対応	非対応	20	20	20	20	25
125 W	非対応	非対応	非対応	20	25	25	25	30
115 W	非対応	非対応	非対応	25	25	25	25	30
105 W	非対応	非対応	非対応	25	25	25	25	30
85 W	非対応	非対応	非対応	30	30	30	30	>35
70 W	非対応	非対応	非対応	>35	>35	>35	>35	>35

## 動作時の拡張温度の仕様

表 14. 動作時の拡張温度

動作時の拡張温度	仕様
継続動作	<p>相対湿度 5%~85%、最大露点温度 29°C で、5°C~40°C。</p> <p><b>i</b> <b>メモ:</b> 標準動作温度(10°C~35°C)の範囲外では、下は 5°C まで、上は 40°C までで、システムは継続的に動作できません。</p> <p>35°C~40°C の場合、950 m を超える場所では 175 m (319 フィート) 上昇することに最大許容温度を 1°C (1°F) 下げます。</p>
年間動作時間の 1 パーセント以下	<p>相対湿度 5%~90%、最大露点温度 29°C で、-5°C~45°C。</p> <p><b>i</b> <b>メモ:</b> 標準動作温度範囲 (10°C~35°C) 外で使用する場合は、最大年間動作時間の最大 1% まで -5°C~45°C の範囲で動作することができます。</p> <p>40°C~45°C の場合、950 m を超える場所では 125 m (228 フィート) 上昇することに最大許容温度を 1°C (1°F) 下げます。</p>

**i** **メモ:** 動作時の拡張温度範囲で使用すると、システムのパフォーマンスに影響が生じる場合があります。

**i** **メモ:** 拡張温度範囲でシステムを使用している際に、システムイベントログに周囲温度の警告が報告される場合があります。

## 動作時温度ディレーティングの仕様

表 15. 動作温度

動作時温度ディレーティング	仕様
≤ 35°C ( 95°F )	950 メートル ( 3,117 フィート ) を超える高度では、最高温度は 300 メートル ( 547 フィート ) ごとに 1°C ( 1°F ) 低くなります。
35°C ~ 40°C ( 95°F ~ 104°F )	950 メートル ( 3,117 フィート ) を超える高度では、最高温度は 175 メートル ( 319 フィート ) ごとに 1°C ( 1°F ) 低くなります。
≥ 45°C ( 113°F )	950 メートル ( 3,117 フィート ) を超える高度では、最高温度は 125 メートル ( 228 フィート ) ごとに 1°C ( 1°F ) 低くなります。

## 相対湿度の仕様

表 16. 相対湿度の仕様

相対湿度	仕様
ストレージ	最大露点 33 °C ( 91 °F ) で 5~95 % の相対湿度。空気は常に非結露状態であること。
動作時	最大露点 29°C ( 84.2°F ) で 10%~80%の相対湿度。

## 温度の仕様

表 17. 温度の仕様

温度	仕様
ストレージ	-40°C ~ 65°C ( -40°F ~ 149°F )
継続動作 ( 高度 950 m ( 3117 フィート ) 未満 )	10°C ~ 35°C ( 50°F ~ 95°F )、装置への直射日光なし。
Fresh Air	外気に関する詳細については、拡張動作温度の項を参照してください。
最大温度勾配 ( 動作時および保管時 )	20°C/h ( 68°F/h )

① **メモ:** 一部の構成では、より低温の周囲温度が必要です。詳細については、「[動作時の標準温度の仕様](#)」を確認してください。

## 温度制限

表 18. デュアルプロセッサ用の熱制限マトリックス

最大継続動作時の吸気口温度 (°C)													
				3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ					非 BP シャーシ	
TDP (ワット)	Proc No.	DPN CPU ヒートシンク	最大 DIMM スロット数	12 x Hdd	HDD	HDD	24x Hdd	20 倍 Hdd	DDR4 Hdd	12 x Hdd	HDD	HDD	該当なし
165W	6238R	CPU1{ A7、CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8	非対応			30	30	30	30	30	35	35

最大継続動作時の吸気口温度 (°C)													
	6240R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8	非対 応	非対応		30	30	30	30	30	35	35
150W	6230R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6226R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6208 U	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
150W	5220 R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
130W	4215R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8		25	25	30	30	35	35	35	35	35
125W	5218R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8	25	30	30	30	35	35	35	35	35	
100W	4214R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210R	CPU1: 8   CPU2: 8	CPU1: 8   CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
95W	42 10T	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	3206R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8   CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 19. シングルプロセッサ用の熱制限マトリックス

最大継続動作時の吸気口温度 (°C)														
				3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						非 BP シャーシ	
TDR(ワット)	Proc No.	DPN CPU ヒートシンク	最大 DIMM スロット数	12 x Hdd	HDD	HDD	24x Hdd	20 倍 Hdd	ddr4 Hdd	12 x Hdd	HDD	HDD	HDD	該当なし

最大継続動作時の吸気口温度 (°C)													
165W	6238R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150W	6230R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6226R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6208U	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
130W	4215R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125W	5218R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100W	4214R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
95W	42 10T	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	3206R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8  CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

## 粒子状およびガス状汚染物質の仕様

表 20. 粒子状汚染物質の仕様

粒子汚染	仕様
空気清浄	データセンターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1 の ISO クラス 8 の定義に準じて、95% 上限信頼限界です。

**①** **メモ:** この条件は、データセンター環境のみに適用されます。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータセンター外での使用のために設計された IT 装置には適用されません。

**①** **メモ:** データセンターに吸入される空気は、MERV11 または MERV13 フィルタで濾過する必要があります。

粒子汚染	仕様
伝導性ダスト	空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウイスカ、またはその他伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。
<p><b>①   メモ:</b> この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>	
腐食性ダスト	空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。
<p>空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度 60% 未満である必要があります。</p>	
<p><b>①   メモ:</b> この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。</p>	

表 21. ガス状汚染物質の仕様

ガス状汚染物	仕様
銅クーポン腐食度	クラス G1 ( ANSI/ISA71.04-2013 の定義による ) に準じ、ひと月あたり 300 Å 未満
銀クーポン腐食度	クラス G1 ( ANSI/ISA71.04-2013 の定義による ) に準じ、ひと月あたり 200 Å 未満
<p><b>①   メモ:</b> 50% 以下の相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル</p>	

## 最大振動の仕様

表 22. 最大振動の仕様

最大耐久震度	仕様
動作時	0.26 Grms ( 5 ~ 350 Hz ) ( 全稼働方向 )。
ストレージ	1.88 Grms ( 10 ~ 500 Hz ) で 15 分間 ( 全 6 面で検証済 )。

## 最大衝撃の仕様

表 23. 最大衝撃の仕様

最大耐久衝撃	仕様
動作時	X、y、z 軸の正および負方向に 6 G の衝撃パルス を 24 回、11 ミリ秒以下 ( システムの各面に対して 4 パルス )。
ストレージ	X、y、z 軸の正および負方向に 2 ミリ秒以下で 71 G の 6 連続衝撃パルス ( システムの各面に対して 1 パルス )。

## 最大高度の仕様

表 24. 最大高度の仕様

最大高度	仕様
動作時	3048 m ( 10,000 ft )
ストレージ	12,000 m ( 39,370 フィート )

# Fresh Air 動作

## Fresh Air 動作の制限

- ・ TDP が 105 W を超えるプロセッサはサポートされない
- ・ PERC 制限のない 85 W 以下のプロセッサのサポート
- ・ 3.5 インチ ドライブ構成はサポートされない
- ・ CPU1 ソケットのプロセッサに 114 mm のヒートシンクが必要
- ・ Kerby-flat OCP はサポートされない
- ・ DCS メザニン スロット上の M.2 カードはサポートされない
- ・ NVMe SSD はサポートされない
- ・ AEP DIMM および LRDIMM はサポートされない
- ・ 25 W を超える PCIe カードはサポートされない
- ・ 105 W のプロセッサの H730 PERC および H330 のサポート
- ・ 85 W 以下の TDP プロセッサには PERC 制限なし

## マニュアルリソース

本項では、お使いのシステムのマニュアルリソースに関する情報を提供します。

マニュアル リソースの表に記載されているマニュアルを参照するには、次の手順を実行します。

- ・ Dell EMC サポート サイトにアクセスします。
  1. 表の「場所」列に記載されているマニュアルのリンクをクリックします。
  2. 目的の製品または製品バージョンをクリックします。
    - ① **メモ:** 製品名とモデルを確認する場合は、お使いのシステムの前面を調べてください。
  3. [製品サポート] ページで、マニュアルおよび文書をクリックします。
- ・ 検索エンジンを使用します。
  - ・ 検索 ボックスに名前および文書のバージョンを入力します。

表 25. お使いのシステムのためのその他マニュアルのリソース

タスク	文書	場所
システムのセットアップ	<p>システムをラックに取り付けて固定する方法の詳細については、お使いのラック ソリューションに同梱の『ルール取り付けガイド』を参照してください。</p> <p>お使いのシステムのセットアップの詳細については、システムに同梱の『はじめに』マニュアルを参照してください。</p>	<a href="http://www.dell.com/poweredgemanuals">www.dell.com/poweredgemanuals</a>
システムの設定	<p>iDRAC 機能、iDRAC の設定と iDRAC へのログイン、およびシステムのリモート管理についての情報は、『Integrated Dell Remote Access Controller ユーザーズ ガイド』を参照してください。</p> <p>RACADM ( Remote Access Controller Admin ) サブコマンドとサポートされている RACADM インターフェイスを理解するための情報については、『RACADM CLI Guide for iDRAC』を参照してください。</p> <p>Redfish およびそのプロトコル、サポートされているスキーマ、iDRAC に実装されている Redfish Eventing の詳細については、『Redfish API Guide』を参照してください。</p> <p>iDRAC プロパティ データベース グループとオブジェクトの記述の詳細については、『Attribute Registry Guide』を参照してください。</p>	<a href="http://www.dell.com/poweredgemanuals">www.dell.com/poweredgemanuals</a>
	<p>iDRAC ドキュメントの以前のバージョンの詳細については、iDRAC ドキュメントを参照してください。</p> <p>お使いのシステムで使用可能な iDRAC のバージョンを特定するには、iDRAC Web インターフェイスで <b>?</b>、<b>About</b> の順にクリックします。</p>	<a href="http://www.dell.com/idracmanuals">www.dell.com/idracmanuals</a>
	オペレーティング システムのインストールについての情報は、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。	<a href="http://www.dell.com/operatingsystemmanuals">www.dell.com/operatingsystemmanuals</a>

タスク	文書	場所
システムの管理	デルが提供する Systems Management Software についての情報は、『Dell OpenManage Systems Management 概要ガイド』を参照してください。	<a href="http://www.dell.com/poweredgemanuals">www.dell.com/poweredgemanuals</a>
	OpenManage のセットアップ、使用、およびトラブルシューティングについての情報は、『Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。	<a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a> > OpenManage Server Administrator
	Dell OpenManage Essentials のインストール、使用、およびトラブルシューティングについての情報は、『Dell OpenManage Essentials ユーザーズガイド』を参照してください。	<a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a> > OpenManage Essentials
	Dell OpenManage Enterprise のインストール、使用、およびトラブルシューティングについての情報は、『Dell OpenManage Essentials ユーザーズガイド』を参照してください。	<a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a> > OpenManage Enterprise
	Dell SupportAssist のインストールおよび使用の詳細については、『Dell EMC SupportAssist Enterprise ユーザーズガイド』を参照してください。	<a href="https://www.dell.com/serviceabilitytools">https://www.dell.com/serviceabilitytools</a>
	パートナープログラムのエンタープライズシステム管理についての情報は、OpenManage Connections Enterprise Systems Management マニュアルを参照してください。	<a href="http://www.dell.com/openmanagemanuals">www.dell.com/openmanagemanuals</a>
Dell PowerEdge RAID コントローラの操作	Dell PowerEdge RAID コントローラ (PERC)、ソフトウェア RAID コントローラ、BOSS カードの機能を把握するための情報や、カードの導入に関する情報については、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。	<a href="http://www.dell.com/storagecontrollermanuals">www.dell.com/storagecontrollermanuals</a>
イベントおよびエラーメッセージの理解	システム ファームウェア、およびシステム コンポーネントをモニタリングするエージェントによって生成されたイベント メッセージとエラーメッセージの情報は、『Error Code Lookup』を参照してください。	<a href="http://www.dell.com/qrl">www.dell.com/qrl</a>
システムのトラブルシューティング	PowerEdge サーバーの問題を特定してトラブルシューティングを行うための情報については、『サーバトラブルシューティングガイド』を参照してください。	<a href="http://www.dell.com/poweredgemanuals">www.dell.com/poweredgemanuals</a>

## 困ったときは

### トピック：

- ・ Dell EMC へのお問い合わせ
- ・ マニュアルのフィードバック
- ・ QRL によるシステム情報へのアクセス
- ・ SupportAssist による自動サポートの利用
- ・ リサイクルまたはサービス終了の情報

## Dell EMC へのお問い合わせ

Dell EMC では、オンラインおよび電話によるサポートとサービス オプションをいくつかご用意しています。お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell EMC 製品カタログで連絡先をご確認ください。これらのサービスは国および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。Dell EMC のセールス、テクニカル サポート、またはカスタマー サービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

### 手順

1. [www.dell.com/support/home](http://www.dell.com/support/home) にアクセスします。
2. お住まいの国を、ページ右下隅のドロップダウンメニューから選択します。
3. カスタマイズされたサポートを利用するには、次の手順に従います。
  - a) **サービス タグを入力**します フィールドに、お使いのシステムのサービス タグを入力します。
  - b) **送信** をクリックします。  
さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
4. 一般的なサポートを利用するには、次の手順に従います。
  - a) 製品カテゴリを選択します。
  - b) 製品セグメントを選択します。
  - c) お使いの製品を選択します。  
さまざまなサポートのカテゴリをリストアップしているサポートページが表示されます。
5. Dell EMC グローバル テクニカル サポートへのお問い合わせ先の詳細については、次の手順に従います。
  - a) [ **グローバルテクニカルサポート** ] をクリックします。
  - b) [ **テクニカル サポートへのお問い合わせ** ] ページには、Dell EMC グローバル テクニカル サポート チームへの電話、チャット、または電子メール送信のための詳細が記載されています。

## マニュアルのフィードバック

任意の Dell EMC マニュアル ページでマニュアルを評価、またはフィードバックを書き、[ **フィードバックの送信** ] をクリックしてフィードバックを送信することができます。

## QRL によるシステム情報へのアクセス

PowerEdge R930 の前面にある情報タグに記載されているクイック リソース ロケーター (QRL) を使用して、Dell EMC PowerEdge R930 に関する情報にアクセスできます。

### 前提条件

お使いのスマートフォンまたはタブレットに QR コードスキャナーがインストールされていることを確認します。

QRL には、お使いのシステムに関する次の情報が含まれています。

- ・ ハウツービデオ
- ・ インストールおよびサービス マニュアル、機械的概要などの参照資料

- ・ 特定のハードウェア構成および保証情報に簡単にアクセスするためのシステムのサービス タグ
- ・ テクニカルサポートや営業チームへのお問い合わせのためのデルへの直接的なリンク

## 手順

1. [www.dell.com/qrl](http://www.dell.com/qrl) にアクセスして、お使いの製品に移動する、または
2. システム上、または「クイックリソースロケータ」セクションで、お使いのスマートフォンまたはタブレットを使用してモデル固有のクイックリソース (QR) コードをスキャンします。

## C6400 および C6420 システム用 QRL



図 2. PowerEdge C6400 および C6420 システム用 QRL

## SupportAssist による自動サポートの利用

Dell EMC SupportAssist は、Dell EMC のサーバ、ストレージ、ネットワーキング デバイスのテクニカル サポートを自動化するオプションの Dell EMC Services です。SupportAssist アプリケーションをインストールしてご利用の IT 環境にセットアップすると、次のようなメリットがあります。

- ・ **自動課題検知**— SupportAssist により、ご利用の Dell EMC デバイスを監視し、プロアクティブかつ予測的にハードウェアの課題を自動検知します。
- ・ **ケースの自動作成**— 課題が検知されると、SupportAssist によって Dell EMC テクニカル サポートへのサポート ケースが自動的に開きます。
- ・ **自動診断収集**— SupportAssist により、ご利用のデバイスからシステム状態に関する情報を自動的に収集し、Dell EMC に安全にアップロードします。この情報は、Dell EMC テクニカル サポートによる、課題のトラブルシューティングに使用されます。
- ・ **プロアクティブな連絡**— Dell EMC テクニカル サポート エージェントがサポート ケースについて連絡し、課題を解決するお手伝いをします。

使用可能なサービスは、お使いのデバイス用に購入した Dell EMC Service の利用資格に応じて異なります。SupportAssist の詳細については、[www.dell.com/supportassist](http://www.dell.com/supportassist) を参照してください。

## リサイクルまたはサービス終了の情報

特定の国では、この製品の引き取りおよびリサイクル サービスが提供されます。システム コンポーネントを廃棄する場合は、[www.dell.com/recyclingworldwide](http://www.dell.com/recyclingworldwide) にアクセスし、該当する国を選択します。